

Japan adds 23 chipmaking tool types to its export licence list from 23 July

Source copy kept by wheresthe.ai for the story "Japan adds 23 chipmaking tool types to its export licence list from 23 July" (<https://wheresthe.ai/d/jp-meti-23-chip-equipment-export-controls-2023-05/>).

Source: <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/japanese-government-imposes-additional-controls-on-semiconductor-related-items/>

Text saved 18 Oct 2026 (the page as published).

SHA-256 of the saved text: d3c52ba3375050e0d1494399984b1f1cd1e6a0a78987b2d9d0fbaf569fbad4ba

Share

Share on Facebook

Share on Twitter

Email

On May 23, 2023, Japanese government announced an amendment of the export control regulations on the additional semiconductor related items, which will go into effect on July 23, 2023.

The overview of the amendment of the Products and Technologies Specifications Ministry Order ("Ministry Order"), to which specific products and technologies were added to the controlled items, is as follows:

From the international peace keeping and security point of view, items related with advanced semiconductor manufacturing devices were added so that they are subject to the export control regulations.

In addition, in order to have programs designed for a use of additional items to be subject to the export control, additional provisions were added to the Ministry Order.

The followings are the additional items to be subject to the export control:

Items Provision of the Ministry Order Cleaning (3 items) Item 17 (ya)-(ke) Deposition (Film formation) (11 items) Item 17 (re)-(o) Annealing (Heat treatment) (1 item) Item 17 (ku) Lithography (Exposure) (four items) Item 17 (ru)-(wa), Item 17-2 Etching (Chemical removal) (3 items) Item 17 (ka)-(ta) Inspection (1 item) Item 17 (fu)

The following guidelines would be amended accordingly.

Guideline for the Operation of the Export Control Order

Guideline for the documentation and concerns regarding export license

Guidelines for a bulk license

+++++

2023年5月23日、日本政府は、半導体関連製品・技術について輸出規制を及ぼすために、半導体関連製品・技術について輸出規制の対象に追加する改正を行いました。当該改正は、2023年7月23日に発効します。

「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」（以下「貨物等省令」といいます。）等の改正の概要は以下のとおりです。

国際的な平和及び安全の維持の観点から、高性能な半導体製造装置及びこれらを使用するために設計したプログラムを輸出管理の対象とするために、貨物省令に以下の品目が追加されました。

【新たに輸出管理の対象となる品目（23品目）】

品目 貨物等省令（第6条第1項）洗浄（3品目）第17号 ヤからケまで デポジション(成膜) (11品目) 第17号 レからオまで アニール(熱処理) (1品目) 第17号 ク リソグラフィ(露光) (4品目) 第17号 ル からワまで、第17号の2 エッチング(化学的除去) (3品目) 第17号 カ からタまで 検査 (1品目) 第17号 フ

また、手続き等を定める以下の通達についての所要の改正が行われます。

・輸出貿易管理令の運用について

- ・輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
- ・包括取扱許可要領

Categories:

Japanese Export Controls

0

Author Junko Suetomi (Japan)

Tokyo

Related Posts

Japan Export Control Updates: List Control Items and CCS-Related CO₂ Export Approval

December 1, 2025

Japan Export Control Updates: Reimposed Sanctions Against Iran and Entities Added to End User List

October 13, 2025

Japanese Updates Regarding Export Controls and Sanctions Against the Russian Federation, etc.

April 29, 2025